

鉛フリー対応 Lead Free

ボールマウント用粘着性フラックス Adhesive Bond Flux for Mounting Solder-Ball

SOLDERITE BF-31

確実なはんだ付けが可能!
Enables to Form Solder Bumps Certainly!

BF-31

- 転写で容易に塗布が可能です。
高温はんだの bumps を形成した後も、優れた洗浄性を示します。

- Easy to coat by transfer.
- Obtains excellent cleaning quality even after the formation of high temperature solder bumps.

一般特性 General Properties

項目	ITEM	BF-31
色調	Color	黄褐色 Yellowish brown
塩素含有量	Chlorine Content (%)	0.0
粘度	Viscosity (25°C) (Pa·s)	27
はんだ広がり率	Solder spread factor (%)	85以上 More than 85
引火点	Ignition point (°C)	140
洗浄剤	Cleaning detergent	準水系洗浄剤、芳香族系溶剤 Quasi water-soluble detergents or aromatic solvents